

接着・封止材

Weekly Intelligence Report

2026-08-08 | 11件 | 4カ国
troy-technical.jp

今週のキーワード

AI/EV材料

次世代接着・封止材の進化と市場動向

11
件
記事数

4
カ国
対象国

4.5
%
Henkel成長

28
倍
計算高速化

今週の全11記事 — 5軸評価で読むべき記事を選ぶ

各列の見方 — 技術新規性：ブレイクスルー度合い 実用化距離：製品として使える近さ 市場インパクト：業界全体への影響規模
データ信頼性：定量データ・査読の有無 日本関連度：日本の企業・サプライチェーンとの直接的関連性

#	記事タイトル	種別	技術 新規性	実用化 距離	市場 インパクト	データ 信頼性	日本 関連度	一行サマリ
#01	APPLIED Adhesives M&A;	企業戦略						APPLIED Adhesivesが欧州と米国東海岸でM&A;を加速し、Henkelとの提携で包装市場のプレゼンスを強化。
#03	接着剤会議2026	イベント 告知						World Adhesive & Sealant Conference 2026が開催され、業界の最新技術、市場トレンド、規制動向を議論。
#04	APPLIED Adhesives買収	企業戦略						APPLIED AdhesivesがオランダVan Asperenを買収し、欧州包装・ラベリング市場でのプレゼンスを拡大。
#05	Henkel売上上方修正	企業業績						Henkelが接着剤技術部門の好調（有機売上4.5%増）を牽引し、2026年通期売上見通しを上方修正。
#06	Indium次世代PKG材	新製品発表						Indium Corporationが金銀メッキ不要の銅焼結ペーストとBiフリー中温はんだを発表、半導体向けに革新。
#07	住友ベークライト最高益	企業業績						住友ベークライトがAIトレーニング用シリコン向け先端封止材で過去最高売上3,050億円を達成。
#08	Univar Solutions買収	企業戦略						Univar SolutionsがH.M. Royalを買収し、米国全土でゴム・プラスチック・接着剤添加剤の流通能力を拡大。
#09	Emerson AIテスト買収	企業戦略						EmersonがAI対応検証・テストソフトウェアのGlue Inc.を買収し、ソフトウェア定義型テスト戦略を加速。
#10	剥離接着剤市場予測	市場予測						光活性化剥離可能構造接着剤市場が、持続可能性とリサイクルニーズを背景に2026-2032年に成長予測。
#11	Dexerials堅調	企業業績						Dexerialsが機能性材料事業の堅調を報告し、CIOE 2026出展やオフィス刷新でイノベーションを加速。
#13	Resonac計算高速化	学術的ブレイクスルー						ResonacがQC Wareとの協業で化学反応遷移状態計算を28倍高速化し、半導体材料開発効率を大幅向上。

●●●●○ High ●●●○● Med-High ●●○○○ Med ●○○○○ Low | 背景黄色 = 注目記事

今週、判断に影響する3つの問い

① AI/EV向け材料開発、自社は先行しているか？

住友ベークライトがAI用封止材で過去最高売上を達成し、Henkelもモビリティ・エレクトロニクス分野で好調です。次世代半導体やEVバッテリー向け材料の需要が急増する中、貴社の開発ロードマップは市場の速度と方向性に対応できていますか？

② 剥離可能接着剤の市場成長、リサイクル戦略に組み込んでいるか？

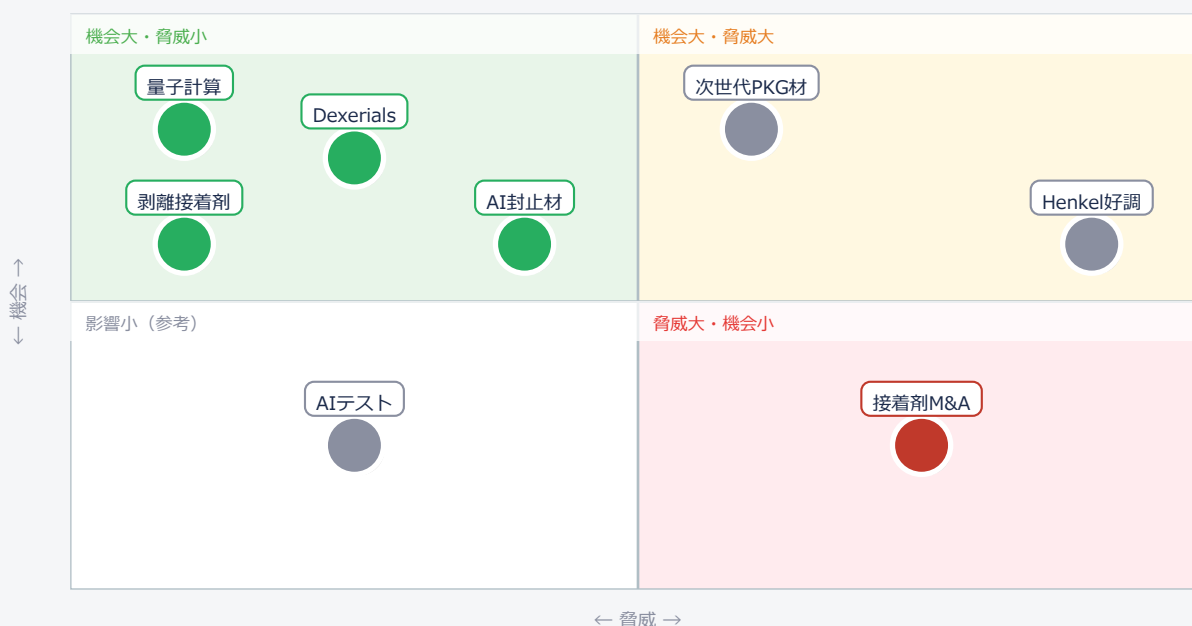
光活性化剥離可能構造接着剤市場が2032年まで成長予測されており、EVバッテリーやエレクトロニクスのリサイクルニーズが高まっています。貴社の製品設計や製造プロセスにおいて、分解・リサイクルを容易にする接着技術の導入を検討していますか？

③ 海外接着剤大手のM&A;加速、サプライチェーンへの影響は？

APPLIED Adhesivesが欧州でM&A;を加速し、Henkelとの提携で市場プレゼンスを拡大しています。グローバルな接着剤サプライヤーの再編が続く中、貴社の調達戦略やサプライチェーンの安定性に対する潜在的な影響を評価し、リスクヘッジ策を講じていますか？

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」

日本企業にとっての「機会 vs 脅威」マトリクス



項目	象限	↑ 機会	↓ 脅威
● 量子計算	機会大	材料開発28倍高速化	競合が先行する可能性
● AI封止材	機会大	AI市場で売上拡大	競合の追随
● 次世代PKG材	注意	コスト減・環境対応	競合に遅れを取る
● Henkel好調	注意	EV/AI市場拡大	競合にシェア奪われる
● 剥離接着剤	機会大	リサイクル需要増	—
● 接着剤M&A;	脅威大	—	サプライヤー再編
● Dexerials	機会大	機能材市場堅調	—

● AIテスト	参考	テスト効率化	—
---------	----	--------	---

深掘り ① — Resonac、量子計算で材料開発を加速

#13 | 2026/08/04 | Resonac (公式ウェブサイト) | 技術新規性●●●●● 実用化距離●●○○○ 市場インパクト●●●●●
データ信頼性●●●●● 日本関連度●●●●●

ResonacはQC Wareとの協業により、化学反応の遷移状態計算を従来比で約28倍高速化する次世代計算化学技術を実証しました。このブレイクスルーは、新材料の設計や触媒開発においてボトルネックとなっていた計算コストと時間を劇的に削減する可能性を秘めています。

特に半導体材料開発では、微細化・高性能化に伴い材料探索の複雑性が増しており、本技術は新たな誘電体、配線、封止材などの開発期間短縮に貢献します。これにより、半導体製造の競争力強化に直結し、マテリアルズ・インフォマティクスをさらに加速させるでしょう。

▶ 技術者の視点

【技術者の視点】遷移状態計算の28倍高速化は、材料開発における「トライ&エラー」を大幅に削減し、シミュレーション主導の設計を現実のものとしします。提示された数値は企業発表ですが、量子計算の進展を考慮すれば妥当な範囲と考えられます。実用化には、計算結果の精度検証や、実際の材料特性との相関付けが課題となります。日本企業にとっては、半導体材料開発における国際競争力を飛躍的に高める【機会】であり、この技術を早期に導入できない企業は開発速度で大きく遅れを取る【脅威】となります。R&D;部門は、この技術の適用可能性を早急に評価し、QC Wareのような専門企業との連携を検討すべきです。

深掘り ② — 住友ベークライト、AI向け封止材で最高益

#07 | 2026/08/05 | The Shashi (住友ベークライトの会社情報を含むサイト) | 技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●○ データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●●

住友ベークライトは、AIトレーニング用シリコン向け先端封止材事業が好調に推移し、2025年3月期に過去最高の売上高3,050億円を達成しました。同社は材料そのものよりも用途に焦点を当てる戦略で、高発熱・高集積化が進むAI半導体パッケージングの課題解決に貢献しています。

この成果は、高性能エポキシ樹脂配合材などの提供を通じて、AI・半導体産業の成長を材料面から支える同社の強みを示しています。グローバルなAI需要の拡大を背景に、日本企業が先端材料分野で確固たる地位を築いている好例と言えます。

▶ 技術者の視点

【技術者の視点】AI向け封止材の需要増は予測されていましたが、住友ベークライトが具体的な売上増に繋がったことは、同社の技術力と市場戦略の適切さを示しています。提示された売上高は実績値であり信頼性は高いです。AIチップのさらなる高集積化・高発熱化に対応するためには、放熱性、低誘電性、信頼性のさらなる向上が未解決課題として残ります。日本企業にとっては、AI市場の成長を材料技術で支える大きな【機会】であり、特に半導体PKGメーカーは、このような高性能封止材を安定的に調達できるサプライチェーンを確保することが重要です。R&D;部門は、AI向け材料の要求特性を常にアップデートし、材料メーカーとの連携を強化すべきです。

深掘り ③ — Indium、次世代半導体PKG材料を発表

#06 | 2026/07/30 | Indium Corporation | 技術新規性●●●●○ 実用化距離●●●●○ 市場インパクト●●●●○
データ信頼性●●●●○ 日本関連度●●●●○

Indium Corporationは、ICEPT 2026で金銀メッキ不要の高信頼性銅焼結ペーストとBiフリー中温はんだを発表しました。銅焼結ペーストは、金銀メッキなしで高信頼性と接合強度を実現し、コスト削減とプロセス簡素化に貢献します。

Biフリー中温はんだは、環境規制強化と高性能化に対応し、鉛・ビスマスフリーで優れた接合信頼性と熱疲労耐性を提供します。これらの材料は、高出力半導体、EV、5Gインフラ、AI関連ハードウェアなど、次世代エレクトロニクス製造の持続可能性と性能向上に不可欠です。

▶ 技術者の視点

【技術者の視点】金銀メッキ不要の銅焼結ペーストは、半導体パッケージングにおけるコストとプロセスの大幅な改善をもたらす可能性があり、非常に注目すべき技術です。Biフリー中温はんだも、環境負荷低減と信頼性向上を両立する点で重要です。発表は学会でのものであり、具体的な定量データや長期信頼性データが待たれます。特に、金銀メッキ不要での長期信頼性確保は技術的なハードルが高いと予想されます。日本企業にとっては、これらの新材料を早期に評価・導入することで、製造コスト削減と環境対応を両立させる【機会】となりますが、海外企業が先行しているため、競合に遅れを取る【脅威】も存在します。半導体PKG部門は、サンプル入手と評価を急ぐべきです。

その他の注目記事

Henkel、接着剤技術部門の好調な成長（有機売上4.5%増）が牽引し2026年通期売上見通しを上方修正（Henkel）
技術新規性●●○○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●●○

接着剤最大手Henkelの好調は、EVやエレクトロニクス市場の堅調な需要を反映。日本の競合企業は市場トレンドと戦略を再評価すべき。

光活性化剥離可能構造接着剤市場、2026年から2032年に持続可能性とリサイクルニーズで成長予測（Digital Journal）
技術新規性●●●○○ 実用化距離●●●○○ 市場インパクト●●●●○

EVバッテリーやエレクトロニクスのリサイクル需要が剥離可能接着剤市場を牽引。日本の材料メーカーは環境対応製品開発を加速すべき。

Dexerials、2026年第1四半期連結決算で機能性材料事業の堅調を報告、CIOE 2026出展やオフィス刷新でイノベーション加速（Dexerials Corporation）
技術新規性●●○○○ 実用化距離●●●●● 市場インパクト●●●○○

日本の機能性材料大手Dexerialsが堅調な業績を維持。ACFやSVRなど主力製品がスマホ・自動車向けに貢献し、イノベーション投資も継続。

今週のアクション提案

記事評価マトリクスと機会/脅威分析を踏まえたアクション提案です。

■ 即時（今週中）

- 【R&D;】 Resonacの量子計算化学技術に関する詳細情報を収集し、自社材料開発への適用可能性について初期検討を開始。
- 【調達】 APPLIED AdhesivesのM&A;（#01, #04）によるサプライヤー再編が、既存の接着剤調達ルートに与える影響を評価し、代替サプライヤーのリストアップに着手。

■ 短期（1ヶ月）

- 【R&D;半導体PKG】 Indium Corporationの金銀メッキ不要銅焼結ペーストおよびBiフリー中温はんだ（#06）の技術詳細を調査し、サンプル評価の可能性を検討。特に信頼性データに注目。
- 【経営企画/R&D;】 Henkelの接着剤技術部門の好調（#05）を分析し、特にモビリティ&エレクトロニクス分野における市場トレンドと競合戦略を把握。自社のポジショニングを再評価。
- 【R&D;EV設計】 光活性化剥離可能構造接着剤市場の成長予測（#10）を参考に、EVバッテリーパックの分解・リサイクル設計における採用可能性について、初期の技術要件とコスト評価を実施。

■ 中長期（四半期～）

- 【経営企画/R&D;】 AI・高性能コンピューティング向け封止材のロードマップを再構築。住友ベークライトの成功事例（#07）を参考に、高機能材料のニーズと開発戦略を策定。
- 【R&D;DX推進】 AIを活用した材料開発・テスト効率化の導入計画を策定。Resonacの計算高速化技術（#13）やEmersonのAIテストソフトウェア買収（#09）を参考に、デジタルツインやマテリアルズ・インフォマティクスへの投資を検討。

接着・封止材 採用記事全文集

出力日: 2026-08-08

採用記事数: 11 件

収録記事一覧

- #01 APPLIED Adhesives、欧州と米国東海岸でのM&AとHenkelとの提携で事業拡大を加速
- #03 World Adhesive & Sealant Conference 2026、3日間にわたり業界の知見とネットワーキングを提供
- #04 APPLIED Adhesives、オランダVan Asperen買収で欧州包装・ラベリング市場のプレゼンスを拡大
- #05 Henkel、接着剤技術部門の好調な成長（有機売上4.5%増）が牽引し2026年通期売上見通しを上方修正
- #06 Indium Corporation、ICEPT 2026で金銀メッキ不要の高信頼性銅焼結ペーストとBiフリー中温はんだを発表
- #07 住友ベークライト、AIトレーニング用シリコン向け先端封止材が牽引し2025年3月期に過去最高売上3,050億円を達成
- #08 Univar Solutions、H.M. Royal買収により米国全土でゴム・プラスチック・接着剤添加剤の流通能力を拡大
- #09 Emerson、AI対応検証・テストソフトウェアのGlue Inc.を買収しソフトウェア定義型テスト戦略を加速
- #10 光活性化剥離可能構造接着剤市場、2026年から2032年に持続可能性とリサイクルニーズで成長予測
- #11 Dexerials、2026年第1四半期連結決算で機能性材料事業の堅調を報告、CIOE 2026出展やオフィス刷新でイノベーション加速
- #13 Resonac、QC Wareとの協業で化学反応遷移状態計算を28倍高速化、半導体材料開発効率を大幅向上

#01 APPLIED Adhesives、欧州と米国東海岸でのM&AとHenkelとの提携で事業拡大を加速

公開日 2026年08月06日 APPLIED Adhesives アメリカ

 01_APPLIED Adhesives、欧州と米国東海岸でのM&AとHenkelとの提携で事業拡大を加速

概要

APPLIED Adhesivesは、オランダのVan Asperen Kleefstoffenを買収し欧州でのプレゼンスを拡大したほか、Industrial Sales and Distribution (ISD) を買収して米国東海岸でのシリコンソリューションを強化しました。さらに、同社はHenkelのフレキシブル包装技術の米国独占販売代理店に指名され、これにより包装市場における提供能力を大きく強化しています。これらの戦略的な動きは、同社のグローバルな事業拡大と顧客への幅広いソリューション提供を加速させるものです。

主要成果

APPLIED Adhesivesは、複数の戦略的買収とパートナーシップを通じて、欧州市場への進出、米国東海岸でのプレゼンス強化、および包装市場における提供能力の拡大を同時に実現し、その事業拡大を大きく加速させています。これらの動きは、同社が接着剤および関連ソリューションのリーディングプロバイダーとしての地位を固めるものです。

技術・臨床詳細

APPLIED Adhesivesが発表した主な戦略的進展は以下の通りです。

- **Van Asperen Kleefstoffenの買収による欧州進出**：APPLIED Adhesivesは、オランダを拠点とする接着剤ソリューションプロバイダーであるVan Asperen Kleefstoffenを買収しました。これは同社にとってオランダでの初の買収であり、欧州での2番目の買収となります。Van Asperenは、Henkelと3Mのプレミアムパートナーであり、包装、ラベリング、紙加工市場向けに高品質な接着剤ソリューションを提供してきました。この買収により、APPLIED Adhesivesは欧州市場での強力な足がかりを築き、地域におけるサービス提供能力を大幅に向上させます。
- **Industrial Sales and Distribution (ISD) の買収による米国東海岸強化**：APPLIED Adhesivesは、接着剤およびシリコンの販売代理店であるIndustrial Sales and Distribution (ISD) を買収しました。ISDは、航空宇宙、製品組立、パッド印刷市場で技術的専門知識と特殊なソリューションを提供しており、この買収により、APPLIED Adhesivesはシリコンソリューションのポートフォリオを拡大し、米国東海岸地域における市場力バレッジと専門知識を強化します。
- **Henkelとのフレキシブル包装技術の米国独占販売提携**：APPLIED Adhesivesは、Henkelの包装用接着剤事業の米国における独占販売代理店に指名されました。この提携は、フレキシブル包装市場でのAPPLIED Adhesivesのプレゼンスを強化し、Henkelの革新的な接着剤およびコーティング技術を米国のコンバーターに提供することを目的としています。食品・飲料、健康・美容、ペット製品などのアプリケーションに焦点を当て、高性能、規制遵守、持続可能性のニーズに対応します。

これらの統合された戦略は、顧客への包括的な製品と技術サポートの提供を可能にし、それぞれの市場での競争優位性を確立します。

背景・業界文脈

接着剤およびシーラント市場は、グローバル化と産業統合が加速する中で、競争が激化しています。企業は、市場シェアを拡大し、特定の技術分野や地域での専門知識を深めるために、戦略的買収や提携を積極的に行っています。特に、包装、航空宇宙、エレクトロニクスといった成長市場では、高性能かつ環境に配慮した接着ソリューションへの需要が高まっており、サプライヤーはこれに対応するために製品ポートフォリオとサービスネットワークの拡充が求められています。APPLIED Adhesivesの一連の動きは、このような業界のトレンドを反映したものです。

今後の展望

APPLIED Adhesivesの一連の戦略的な動きは、同社を接着剤市場における主要なグローバルプレーヤーへと押し上げるでしょう。欧州市場への本格的な参入、米国東海岸でのシリコンソリューション強化、そしてHenkelとの提携による包装市場でのリーダーシップ確立は、同社の成長軌道をさらに加速させます。これにより、より多くの顧客に対して、地域に根差した専門的なサポートと、幅広い高性能接着ソリューションを提供できるようになり、多様な産業分野における顧客のイノベーションと生産性向上に貢献することが期待されます。今後は、既存市場でのシェア拡大とともに、新たな地域やアプリケーション分野への展開も視野に入れていると考えられます。

元記事: <https://www.appliedadhesives.com/category/press-release/>

#03 World Adhesive & Sealant Conference 2026、3日間にわたり業界の知見とネットワーキングを提供

公開日 2026年09月01日 World Adhesive & Sealant Conference 国際

 03_World Adhesive & Sealant Conference 2026、3日間にわたり業界

概要

World Adhesive & Sealant Conference 2026は、接着剤・シーラント業界のグローバルリーダー、研究者、技術者が集結する3日間のイベントです。プレナリーセッション、ブレイクアウトセッション、EXPO、およびネットワーキングソーシャルイベントを通じて、参加者は最新の市場トレンド、技術革新、規制動向に関する深い知見を得るとともに、業界内外の専門家との交流を深めることができます。本会議は、業界の持続可能な成長と発展に貢献することを目指します。

主要成果

「World Adhesive & Sealant Conference 2026」は、接着剤およびシーラント業界の専門家が一堂に会し、最新の技術動向、市場戦略、規制の枠組みについて議論する、年に一度のグローバルイベントとして開催されます。この3日間の会議は、業界のイノベーションを促進し、参加者間の知識共有とネットワーキングを最大化することに焦点を当てています。

技術・臨床詳細

本会議は、接着剤・シーラント分野における最先端のトピックを幅広くカバーする予定です。主要なセッションの内容は以下の通りです。

- **プレナリーセッション**：業界をリードする思想家や経営者が、マクロ経済のトレンド、グローバルな市場の課題、そして接着剤・シーラント技術が直面する将来的な機会について、高レベルの洞察を提供します。特に、環境規制、持続可能性、デジタル化が業界に与える影響が議論されるでしょう。
- **ブレイクアウトセッション**：より専門的なテーマに焦点を当て、以下の技術的進歩が詳述されます。
 - **高性能接着剤**：自動車の軽量化、エレクトロニクス部品の小型化、建築物のエネルギー効率向上などに貢献する、次世代の構造用接着剤、熱伝導性接着剤、電気伝導性接着剤。
 - **環境配慮型シーラント**：低VOC、バイオベース、リサイクル可能な素材を使用したシーラントなど、環境フットプリントの削減を目指すソリューション。
 - **スマート接着技術**：センシング機能を持つ接着剤、自己修復接着剤、デボンディング・オンデマンド接着剤など、新たな機能を付加した製品。
 - **製造と塗布の自動化**：接着剤の精密塗布、ロボットによる自動化、品質管理のためのAI活用など、生産プロセスの効率化技術。
- **EXPO**：主要な接着剤・シーラントメーカー、原材料サプライヤー、設備メーカーが最新製品と技術を展示します。これにより、参加者は実物を見て触れることで、具体的なソリューションを評価できます。

これらのセッションは、技術者、研究者、ビジネス開発担当者にとって、実践的な知見と戦略的な視点を提供する貴重な機会となります。

背景・業界文脈

接着剤およびシーラント産業は、製造業における軽量化、異種材料接合、耐久性向上、そして持続可能性への要求の高まりを受けて、継続的に成長しています。グローバル市場は、自動車、建築・建設、パッケージング、エレクトロニクス、医療など、多岐にわたるエンドユース産業からの需要によって牽引されています。このような背景の中で、新しい技術動向を理解し、国際的な協力関係を築くことは、企業が競争力を維持し、将来の成長機会を捉える上で不可欠です。

今後の展望

World Adhesive & Sealant Conference 2026は、業界の未来を形作る上での重要な役割を果たすでしょう。提供される知見とネットワーキングの機会は、参加企業が新たなR&Dの方向性を定め、戦略的パートナーシップを構築し、市場の課題を克服するための重要な基盤となります。特に、持続可能な製品開発とデジタル技術の導入は、今後の業界成長の主要な推進力となり、より高性能で環境に優しい接着剤・シーラントソリューションが、様々な産業分野のイノベーションを加速させることが期待されます。

元記事: <https://www.wac2026.org/>

#04 APPLIED Adhesives、オランダVan Asperen買収で欧州包装・ラベリング市場のプレゼンスを拡大

公開日 2026年08月06日 PR Newswire アメリカ



概要

APPLIED Adhesivesは、オランダの接着剤ソリューションプロバイダーVan Asperen Kleefstoffenを買収し、欧州市場での戦略的拡大を図りました。この買収により、包装、ラベリング、紙加工分野におけるAPPLIEDの地位が強化され、Henkelおよび3Mとの既存のパートナーシップも拡充されます。APPLIEDは、今回の統合を通じて欧州顧客への技術サポートとサービス提供能力を向上させ、地域市場での成長を加速させる方針です。

主要成果

APPLIED Adhesivesは、オランダを拠点とする接着剤ソリューションの専門企業Van Asperen Kleefstoffenの買収を完了し、欧州市場における事業基盤を大幅に強化しました。この戦略的動きは、特に包装、ラベリング、紙加工といった主要セクターにおける同社のプレゼンスを拡大し、顧客へのサービス提供能力を高めるものです。

技術・ビジネス詳細

Van Asperen Kleefstoffenは、接着剤に関する深い専門知識と堅牢な顧客ネットワークを欧州全域で確立しており、今回の買収によりAPPLIED Adhesivesは欧州市場でのフットプリントを効果的に拡大できます。Van Asperenは、Henkelや3Mといった業界大手との長期的な協力関係を有しており、APPLIEDはこれらの貴重なパートナーシップを引き継ぎ、さらに発展させる計画です。この統合により、APPLIEDは多様な接着剤製品群と専門的なアプリケーション知識を欧州の顧客に提供できるようになります。

背景・業界文脈

世界の接着剤市場は、包装、自動車、建設、エレクトロニクスなど多岐にわたる産業で需要が拡大しており、企業は市場シェアの獲得と地域的なリーチ拡大を目指して戦略的なM&Aを活発に行っています。APPLIED Adhesivesは、北米で培ってきた成功を欧州市場にも展開するべく、積極的な成長戦略を進めています。今回の買収は、同社のグローバルサプライチェーンと販売ネットワークを強化し、顧客ニーズにより迅速かつ効果的に対応するための重要なステップです。

今後の展望

APPLIED Adhesivesは、Van Asperen Kleefstoffenの統合を通じて、欧州の顧客に対してより広範な製品ポートフォリオと強化された技術サポートを提供することを目指しています。この買収は、欧州市場における同社の競争力を高め、将来的なさらなる事業拡大に向けた強固な基盤を築くものと期待されています。地域に根ざした専門知識とグローバルなリソースの融合により、APPLIEDは欧州接着剤市場でのリーダーシップを確立することを目指します。

収集日: 2026年08月07日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#05 Henkel、接着剤技術部門の好調な成長（有機売上4.5%増）が牽引し2026年通期売上見通しを上方修正

公開日 2026年08月06日 Henkel (公式プレスリリース) ドイツ



概要

Henkelは、2026年上半期の有機売上高が3.2%増加し、特に接着剤技術部門が4.5%の有機売上成長を牽引したことから、通期の有機売上成長見通しを上方修正しました。接着剤技術部門では、モビリティ & エレクトロニクス分野で7.8%の有機売上高増加を達成し、この好調な業績が全体の利益に大きく貢献しています。同社は、エレクトロニクス市場の需要に対応するため、中国での新スマート工場やインドでの共創ハブへの投資を継続しており、M&A戦略も上半期の業績に寄与しました。

主要成果

ドイツの化学大手Henkelは、2026年上半期に好調な業績を達成し、これを受けて通期の有機売上成長見通しを上方修正しました。特に接着剤技術部門が有機売上高で4.5%の堅調な成長を記録し、これは同社全体の有機売上高3.2%増を大きく牽引する形となりました。この部門の好業績は、その高い利益率とともにHenkelの連結利益に大きく貢献しています。

技術・ビジネス詳細

接着剤技術部門の好調は、特にモビリティ & エレクトロニクス事業分野での二桁成長、具体的には7.8%の有機売上増加に支えられています。これは、電気自動車（EV）や次世代エレクトロニクスデバイス向け接着剤の需要拡大を明確に反映しています。Henkelは、この高成長分野での競争力をさらに強化するため、戦略的な設備投資を継続しており、中国における新たなスマート工場建設や、インドでの顧客との共創ハブ設立はその象徴です。これらの投資は、革新的な材料ソリューションの迅速な開発と供給能力の向上を目指すものです。さらに、同社は接着剤技術部門におけるM&A戦略を成功裏に実行し、これが上半期の好業績に寄与したことも報告しています。

背景・業界文脈

世界的に見ても、エレクトロニクス、自動車、包装といった主要産業における高性能接着剤の需要は高まる一方です。特にEV市場の拡大や5G/AIデバイスの普及は、耐熱性、導電性、軽量化、耐久性といった高度な機能を備えた接着・封止材のニーズを加速させています。Henkelは、早くからこれらのトレンドを捉え、技術革新と市場投入をリードしてきました。グローバルな生産体制と研究開発ネットワークを持つ同社は、地域ごとの需要変動にも柔軟に対応できる強みを持っています。

今後の展望

Henkelは、接着剤技術部門の持続的な成長を基盤とし、2026年通期の有機売上成長率を1.0%~3.0%に上方修正しました。これは、消費財事業の堅調さと合わせて、同社の多角的な事業ポートフォリオが効果的に機能していることを示しています。今後もHenkelは、イノベーションへの投資、戦略的なM&A、そして効率的な生産体制の構築を通じて、グローバル市場でのリーダーシップを維持・拡大していく方針です。特に高成長が期待されるモビリティ & エレクトロニクス分野への注力は、同社の将来的な収益ドライバーとなるでしょう。

元記事: <https://www.henkel.com/press-and-media/press-releases-and-kits/2026-08-06-henkel-delivers-strong-sales-and-earnings-performance-in-the-first-half-and-upgrades-top-line-guidance-for-2026-2217762>

収集日: 2026年08月07日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#06 Indium Corporation、ICEPT 2026で金銀メッキ不要の高信頼性銅焼結ペーストとBiフリー中温はんだを発表

公開日 2026年07月30日 Indium Corporation アメリカ



Reliable Copper Sintering Paste
eliminates the need for gold or silver plating

Bismuth-Free Mid-Temperature Solder

概要

Indium CorporationはICEPT 2026にて、高出力半導体向けの画期的な銅焼結ペーストと次世代エレクトロニクス組立向け鉛フリー・Biフリー中温はんだの2つの先進ソリューションを発表します。この銅焼結ペーストは、金や銀メッキを必要とせず高い信頼性と強力な接合強度を実現し、大幅なコスト削減とプロセス簡素化に貢献します。また、鉛フリー・Biフリーのイン含有中温はんだは、環境規制強化と高性能化に対応し、次世代電子機器の信頼性向上と持続可能性を両立させます。

主要成果

Indium Corporationは、ICEPT 2026（国際電子部品・パッケージング技術会議）において、高出力半導体アプリケーション向けの次世代銅焼結ペーストと、次世代エレクトロニクス組立向けの鉛フリー・ビスマス（Bi）フリーのイン含有中温はんだという、2つの業界を定義するソリューションの進歩を発表します。これらの材料は、半導体パッケージングおよびエレクトロニクス製造における主要な課題を解決し、性能と持続可能性を両立させるものです。

技術・臨床詳細

今回発表される新しい銅焼結ペーストは、特に高出力半導体デバイスの熱管理において重要な進歩をもたらします。従来、焼結プロセスでは金や銀メッキが表面処理として必要とされていましたが、この新材料はそれらを必要とせず高い信頼性と強力な接合強度を提供します。これにより、製造コストの削減、プロセスの簡素化、およびサプライチェーンの効率化が期待されます。また、鉛フリーかつBiフリーのイン含有中温はんだは、環境規制の強化と高性能エレクトロニクスへの需要増大に対応するために開発されました。このはんだは、優れた接合信頼性と熱疲労耐性を持ちながら、有害物質の使用を排除することで、持続可能なエレクトロニクス製造に貢献します。中温域でのプロセスが可能となることで、熱に弱い部品への影響を最小限に抑えつつ、信頼性の高い接合を実現します。

背景・業界文脈

現代のエレクトロニクス産業、特に半導体デバイスは、より小型化、高出力化、高密度化が進んでおり、これに伴い効率的な熱管理と高信頼性の接合技術が不可欠となっています。また、環境規制の厳格化は、鉛やビスマスなどの有害物質を含まない、より環境に優しい材料へのシフトを加速させています。Indium Corporationのこれらの新ソリューションは、こうした市場の要求に直接応えるものであり、特に電気自動車、再生可能エネルギー、5Gインフラ、AI関連ハードウェアなどの分野でその価値を発揮するでしょう。次世代パッケージング技術の進展は、これらの新しい材料が不可欠な要素となります。

今後の展望

Indium Corporationが発表するこれらの革新的な材料は、半導体およびエレクトロニクス製造の未来を形作る上で重要な役割を果たすと期待されています。金銀メッキ不要の銅焼結ペーストは、高出力デバイスの性能向上とコスト削減に貢献し、鉛フリー・Biフリー中温はんだは、環境負荷を低減しつつ次世代電子機器の信頼性を保証します。これらの技術は、エレクトロニクス業界全体の持続可能性と技術的進化を促進し、今後の材料開発の方向性を示すものとなるでしょう。

元記事: <https://www.indium.com/press-releases/indium-corporation-to-present-advancements-in-two-industry-defining-solutions-at-icept-2026/>

収集日: 2026年08月07日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#07 住友ベークライト、AIトレーニング用シリコン向け先端封止材が牽引し2025年3月期に過去最高売上3,050億円を達成

公開日 2026年08月05日 The Shashi (住友ベークライトの会社情報を含むサイト) 日本



概要

住友ベークライトは、AIトレーニング用シリコンに代表される先端パッケージング向け封止材事業が好調に推移し、2025年3月期連結決算で過去最高の売上高3,050億円を達成しました。同社は、材料そのものよりも用途に焦点を当てる戦略を推進しており、半導体封止用エポキシ樹脂配合材などの高性能材料で市場の需要に応えています。この成果は、高機能材料の提供を通じて、AI・半導体産業の成長を支える同社の強みを示しています。

詳細

主要成果

住友ベークライト株式会社は、2025年3月期の連結決算において、売上高が過去最高の3,050億円に達したことを発表しました。この顕著な業績は、主にAIトレーニング用シリコンを含む先端パッケージング向け封止材事業の力強い回復と成長によって牽引されたものです。

技術・ビジネス詳細

同社の封止材事業は、特にAIや高性能コンピューティング（HPC）向け半導体の進化に対応する形で、高機能なエポキシ樹脂配合材などの先端材料を提供しています。これらの材料は、半導体の信頼性向上、放熱性改善、小型化に不可欠であり、過酷な使用環境下での安定稼働を支える上で重要な役割を果たします。住友ベークライトは、単に材料を提供するだけでなく、「材料そのもの」ではなく「その用途」に焦点を当てる戦略を採用しており、顧客の最終製品が抱える課題を解決するソリューションプロバイダーとしての価値提供を重視しています。このアプローチにより、AI技術の発展を支える高性能シリコンパッケージングの需要増を的確に捉え、製品開発と市場投入を加速させました。

背景・業界文脈

近年、AI技術の急速な発展に伴い、その基盤となる高性能半導体、特にAIトレーニング用チップの需要が爆発的に増加しています。これらのチップは、従来の半導体と比較して高発熱・高集積であり、より高度な封止技術が求められます。住友ベークライトのような高機能材料メーカーは、この技術革新の最前線で、半導体メーカーと緊密に連携しながら、次世代パッケージングソリューションの開発に貢献しています。同社の歴史は、フェノール樹脂のパイオニアとしての創業以来、様々な産業分野の発展を材料面から支えてきた実績に裏打ちされており、特にエレクトロニクス分野においては、半導体封止材のトップランナーとしての地位を確立しています。

今後の展望

住友ベークライトは、AI市場の拡大が今後も続くと予測される中で、先端半導体向け封止材事業をさらに強化していく方針です。顧客との共同開発を通じて、より高性能かつ信頼性の高い材料ソリューションを市場に投入し続けることで、AIおよびHPCの進化を材料技術で支える重要な役割を担っていくでしょう。今回の過去最高売上達成は、同社の戦略的投資と技術開発が実を結んだ証であり、持続的な成長に向けた強固な基盤を確立したことを示唆しています。

元記事: <https://the-shashi.com/en/tse/4203/>

収集日: 2026年08月07日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#08 Univar Solutions、H.M. Royal買収により米国全土で ゴム・プラスチック・接着剤添加剤の流通能力を拡大

公開日 2026年08月03日 Coatings World アメリカ



概要

Univar Solutionsは、ゴム、プラスチック、接着剤添加剤の専門流通業者であるH.M. Royalを買収し、米国全土でのパフォーマンスマテリアル事業を強化しました。この買収により、Univar Solutionsは接着剤およびシーラント分野における製品ポートフォリオと専門知識を拡大し、顧客へのサービス提供能力を向上させます。H.M. Royalの確立されたネットワークと技術的知見を統合することで、多様な産業ニーズに対応し、市場での競争力を高める狙いです。

詳細

主要成果

Univar Solutionsは、ゴム、プラスチック、接着剤添加剤の専門流通業者であるH.M. Royalを買収しました。この戦略的買収は、Univar Solutionsのパフォーマンスマテリアル事業を大幅に強化し、特に米国全土における接着剤およびシーラントの流通能力と市場への提供価値を拡大するものです。

技術・ビジネス詳細

H.M. Royalは、高性能ゴム、プラスチック、接着剤添加剤の分野で長年にわたり信頼されるパートナーとして機能してきました。その広範な製品ポートフォリオと専門的な技術サポートは、タイヤ、自動車、建設、エレクトロニクスなどの多岐にわたる産業の顧客に高く評価されています。Univar Solutionsは、H.M. Royalのこれらの強みを自社の広範な流通ネットワークと組み合わせることで、顧客に対してより包括的な材料ソリューションを提供できるようになります。この統合により、両社の持つ専門知識とリソースが結集され、接着剤およびシーラントの配合設計からアプリケーションサポートまで、より深いレベルでの顧客支援が可能となります。

背景・業界文脈

特殊化学品および材料の流通市場は、顧客のサプライチェーン効率化と技術サポートの強化を求める動きが加速しています。M&Aは、企業が製品ラインナップを拡充し、地理的範囲を拡大し、専門性を深めるための主要な手段となっています。Univar Solutionsは、この業界の主要プレイヤーとして、持続的な成長戦略の一環として戦略的な買収を進めてきました。H.M. Royalの買収は、特に成長が見込まれる接着剤・シーラント市場において、Univar Solutionsの地位を確立し、競合他社に対する優位性を築く上で重要な意味を持ちます。

今後の展望

Univar Solutionsは、H.M. Royalの買収を通じて、パフォーマンスマテリアル市場におけるリーダーシップをさらに強化することを目指しています。統合された事業体は、ゴム、プラスチック、接着剤の各分野でより多様な製品と専門的なサービスを提供し、顧客のイノベーションと持続可能性目標の達成を支援します。この買収は、顧客基盤の拡大、製品ポートフォリオの最適化、そして北米市場でのプレゼンスの強化に貢献し、Univar Solutionsの長期的な成長戦略に不可欠な要素となるでしょう。

元記事: <https://www.coatingsworld.com/breaking-news/univar-solutions-acquires-h-m-royal/>

収集日: 2026年08月07日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#09 Emerson、AI対応検証・テストソフトウェアのGlue Inc.を買収しソフトウェア定義型テスト戦略を加速

公開日 2026年08月06日 StockTitan (PR Newswireの転載) アメリカ



概要

Emerson Electric Co.は、AI対応の検証・テストソフトウェア「Glue Studio」の開発元であるGlue Inc.を買収しました。この買収は、Emersonのソフトウェア定義のデータ中心型テスト&測定戦略を加速することを目的としています。Glue Inc.の技術統合により、EmersonはテストワークフローにおけるAI機能を強化し、顧客に提供する自動化ソリューションの効率と精度を大幅に向上させることが可能となります。

詳細

主要成果

Emerson Electric Co.は、AI対応検証・テストソフトウェアの革新企業であるGlue Inc.を買収しました。この戦略的な動きは、Emersonが推進するソフトウェア定義のデータ中心型テスト&測定戦略を加速し、業界における同社の技術的リーダーシップを強化することを目的としています。

技術・ビジネス詳細

Glue Inc.は、特にAI対応検証・テストソフトウェア「Glue Studio」の開発で知られており、複雑なテストワークフローを自動化し、データ分析を強化する能力を持っています。このソフトウェアは、製品開発サイクルを短縮し、テストの精度と効率を向上させることで、企業が市場投入までの時間を短縮し、品質を確保する上で重要な役割を果たします。Emersonは、産業用自動化と計測技術のグローバルリーダーであり、今回の買収により、Glue Inc.のAI技術を自社の広範なテスト&測定ソリューションに統合することが可能になります。これにより、Emersonの顧客は、よりインテリジェントで予測的なテスト環境を享受できるようになり、特に半導体、自動車、航空宇宙などの高精度が要求される分野での競争力が高まるでしょう。

背景・業界文脈

現代の製造業において、製品の複雑化と開発サイクルの短縮は、より高度なテスト&測定ソリューションを必要としています。特にAIの進化は、テストプロセス自体にもAIを活用することで、効率と品質を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。ソフトウェア定義のテストは、物理的なハードウェアに依存することなく、ソフトウェアを通じてテスト環境を柔軟に設定・変更できるため、開発コストの削減と市場変化への迅速な対応を可能にします。Emersonは、この分野でのイノベーションを積極的に追求しており、Glue Inc.の買収は、この戦略の実行における重要なマイルストーンとなります。

今後の展望

Emersonは、Glue Inc.の技術を統合することで、テスト&測定ポートフォリオ全体にわたるAI機能を大幅に強化し、顧客に提供する価値を高めることを目指します。この買収は、産業用IoT（IIoT）とデジタルツイン技術の進化と密接に連携し、テストデータから得られる知見を製品設計、製造プロセス、運用効率の改善に活用する新たな道を開くものです。Emersonの目標は、AI主導のソリューションを通じて、顧客がより迅速に革新し、高品質な製品を市場に投入できるよう支援することにあります。この統合は、テスト&測定業界におけるAIの役割を再定義し、新たな標準を確立する可能性を秘めています。

元記事: <https://www.stocktitan.net/news/EMR/emerson-acquires-glue-inc-to-accelerate-ai-driven-test-measurement-r1asp1gy83jl.html>

収集日: 2026年08月07日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#10 光活性化剥離可能構造接着剤市場、2026年から2032年に持続可能性とリサイクルニーズで成長予測

公開日 2026年08月01日 Digital Journal (24 Market Reportsからのプレスリリース転載) 不明



概要

本記事は、24 Market Reportsが発行した市場調査レポートの概要紹介です。光活性化剥離可能構造接着剤市場は、持続可能性と修理可能・リサイクル可能部品への需要増加を背景に、2026年から2032年にかけて大きく成長すると予測されています。エレクトロニクス、自動車（EVバッテリーエンクロージャ）、医療、産業機器分野での応用が期待されており、特定の光波長で剥離可能な接着剤が容易な分解とリサイクルを可能にします。

詳細

本記事は、24 Market Reportsが発行した市場調査レポートの概要紹介です。

レポート概要

この市場調査レポートは、光活性化剥離可能構造接着剤の世界市場に焦点を当てています。持続可能性への関心の高まりと、エレクトロニクス、自動車（特にEVバッテリーエングロージャ）、医療機器、産業機器といった主要産業における修理可能・リサイクル可能部品の需要増加が、この市場の成長を牽引する主要要因として分析されています。レポートでは、2026年から2032年までの市場予測期間における市場規模、成長率、主要なトレンド、および主要プレイヤーの動向が詳細に調査されています。

主要な調査結果

- 光活性化剥離可能構造接着剤市場は、今後数年間で大幅な成長が見込まれています。
- 主な成長ドライバーは、製品寿命延長、部品リサイクル、廃棄物削減を目的としたサステナブルな製造プロセスの採用です。
- この技術は、特定の光波長を照射することで接着強度を一時的に低下させ、部品を容易に分離・分解できるという点で革新的です。
- 特に、EVバッテリーパックのメンテナンスとリサイクル、スマートフォンの修理、医療機器の分解洗浄といった分野での応用が期待されています。
- 市場の主要プレイヤーは、材料の性能向上、コスト削減、および幅広い産業での用途開拓に注力しています。

発行会社について

24 Market Reportsは、世界中の様々な産業セクターにおける詳細な市場調査レポートを提供するグローバルな市場調査会社です。同社は、データ駆動型のアプローチと深い業界専門知識に基づき、企業が戦略的な意思決定を行うための貴重なインサイトを提供しています。

収集日: 2026年08月07日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#11 Dexerials、2026年第1四半期連結決算で機能性材料事業の堅調を報告、CIOE 2026出展やオフィス刷新でイノベーション加速

公開日 2026年08月04日 Dexerials Corporation (公式ウェブサイト) 日本



概要

Dexerialsは、2026年6月30日を期末とする第1四半期連結決算を発表し、異方性導電膜（ACF）、光学弾性樹脂（SVR）、工業用接着剤などの機能性材料事業が堅調に推移していることを報告しました。同社は、スマートフォン、自動車、その他電子部品分野向けにこれらの材料を提供しています。また、中国のCIOE 2026への出展や東京オフィスの「Empower Synergy Office」への刷新を通じて、共創とイノベーションを積極的に推進する戦略を継続しています。

主要成果

Dexerials Corporationは、2026年6月30日を期末とする第1四半期連結決算を発表し、同社の主要な機能性材料事業が堅調な業績を維持していることを明らかにしました。スマートフォンや自動車といった成長分野向けに、異方性導電膜（ACF）、光学弾性樹脂（SVR）、工業用接着剤などの高機能材料を提供し、市場の需要に応えています。

技術・ビジネス詳細

Dexerialsは、電子部品の接合材料、光学材料、およびその他の機能性材料の開発・製造・販売において世界をリードする企業です。同社の主力製品である異方性導電膜（ACF）は、ディスプレイやカメラモジュールなどの小型・高密度実装に不可欠な材料であり、スマートフォンやタブレットの高性能化に貢献しています。また、光学弾性樹脂（SVR）は、タッチパネルの視認性向上や耐衝撃性確保に利用され、自動車の車載ディスプレイなどにも採用が拡大しています。工業用接着剤は、幅広い産業分野で様々な接合ニーズに応えるソリューションとして提供されています。加えて、同社はイノベーションと共創を促進するための取り組みを強化しており、その一環として中国深センで開催される国際光電博覧会（CIOE 2026）への出展を発表しました。これにより、中国市場での顧客基盤拡大と最新技術の紹介を目指します。また、東京オフィスを「Empower Synergy Office」として刷新し、従業員間の連携強化と新たなアイデア創出を促進する環境を整備しました。これらの活動は、技術革新を支える企業文化と環境整備への投資を示唆しています。譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に係る払込完了についても発表しており、これは経営陣と従業員のモチベーション向上と株主価値向上を目的としたIR戦略の一環です。

背景・業界文脈

グローバルエレクトロニクス市場は、5G、IoT、AIといった新技術の普及により、継続的な成長を遂げています。これに伴い、電子部品の高機能化、小型化、高信頼性化への要求が高まっており、Dexerialsが提供するような先端機能性材料の重要性が増しています。特に、車載エレクトロニクスの発展は、より厳しい環境下での信頼性が求められる材料ソリューションへの需要を押し上げています。Dexerialsは、こうした市場のトレンドを捉え、研究開発と生産能力の強化に注力することで、市場における競争優位性を確立しています。

今後の展望

Dexerialsは、引き続き研究開発投資を強化し、次世代の機能性材料の開発に注力していくでしょう。特に、異方性導電膜や光学弾性樹脂のさらなる高性能化、および新たなアプリケーション領域への展開が期待されます。グローバルな展示会への積極的な参加と、社内イノベーション環境の整備は、同社が今後も市場の変化に迅速に対応し、持続的な成長を実現するための重要な戦略です。これらの取り組みを通じて、Dexerialsは電子部品業界の技術革新をリードし続けることを目指します。

元記事: <https://www.dexerials.jp/en/>

収集日: 2026年08月07日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)

#13 Resonac、QC Wareとの協業で化学反応遷移状態計算を28倍高速化、半導体材料開発効率を大幅向上

公開日 2026年08月04日 Resonac (公式ウェブサイト) 日本



概要

Resonacは、QC Wareとの共同検証により、次世代計算化学技術が化学反応の鍵となる遷移状態計算を従来法より約28倍高速化できることを実証しました。この画期的な技術は、半導体材料をはじめとする実材料開発の効率を大幅に向上させる可能性を秘めています。計算速度の向上は、新素材探索やプロセス最適化の期間短縮に直結し、産業界に大きな影響を与えることが期待されます。

主要成果

Resonac（レゾナック）は、量子コンピューティングソフトウェア開発企業のQC Wareとの協業を通じて、次世代計算化学技術が化学反応分析における遷移状態計算を従来の標準的な手法と比較して約28倍高速化できることを検証しました。この成果は、特に半導体材料開発を含む実材料開発プロセスの劇的な効率向上に直結するものです。

技術・ビジネス詳細

遷移状態計算は、化学反応の経路とエネルギー障壁を理解するために不可欠なプロセスであり、新材料の設計や触媒開発において極めて重要です。しかし、その計算コストは非常に高く、従来のスーパーコンピュータを用いても膨大な時間を要することが課題でした。ResonacとQC Wareが検証した次世代計算化学技術は、高度なアルゴリズムと計算リソースの最適化により、このボトルネックを解消します。約28倍の高速化は、例えば、数週間から数ヶ月かかっていた計算を数日、あるいは数時間で完了できる可能性を示唆しており、これにより研究者はより多くの化合物や反応経路を探索し、最適解に迅速に到達できるようになります。特に半導体材料開発では、微細化と高性能化の要求が高まる中で、わずかな材料組成や構造の違いが最終製品の性能に大きく影響します。本技術の適用により、新たな誘電体材料、配線材料、封止材などの探索・評価プロセスを加速させ、市場投入までの時間を短縮することが期待されます。これは、半導体製造の競争力強化に直接貢献するものです。

背景・業界文脈

材料科学の分野では、実験のみに頼る「トライ&エラー」から、計算科学を活用して効率的に材料を設計する「マテリアルズ・インフォマティクス」へのシフトが加速しています。量子化学計算や分子動力学シミュレーションなどの計算手法は、新材料開発の重要なツールとなっていますが、その計算負荷は常に課題でした。QC Wareのような量子コンピューティング技術を持つ企業との連携は、この課題を克服し、材料開発のデジタル変革をさらに推進するものです。Resonacは、半導体材料から自動車、インフラまで幅広い分野で事業を展開しており、基盤技術としての計算化学の強化は、同社の事業競争力向上に不可欠です。

今後の展望

今回の検証成果は、Resonacが「化学の力で社会を変える」というビジョンのもと、実材料開発のデジタルトランスフォーメーションを推進する上で重要な一歩となります。QC Wareとの協業は、量子コンピューティングや高度な計算化学を実際の産業課題に応用する道を切り開くものであり、今後、半導体以外の分野、例えば電池材料、触媒、高分子材料などの開発にも同様の高速化技術が適用される可能性があります。この技術が広く普及することで、新素材の発見と実用化のサイクルが劇的に短縮され、持続可能な社会の実現に貢献することが期待されます。

元記事: <https://www.resonac.com/>

収集日: 2026年08月07日 | 自動記事収集・翻訳システム (Gemini API使用)